**《智慧鍍膜之發展趨勢及應用展望》報名表**

|  |  |
| --- | --- |
| **公司名稱** |  |
| **公司地址** |  |
| **公司規模** | □中小企業 □非中小企業 |
| **產業別** | 1.製造業 □電子資訊 □生技/醫藥 □醫療器材 □石化 □紡織 □食品□環境安全 □機械金屬 □能源 □其他2.服務業 □批發/零售 □金融保險 □資訊通訊傳播 □專業科技技術□醫療保健 □其他服務業3.□其他行業別3.其他:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_規模 |
| **電話** |  | **傳真** |  |
| **參加人員** | **性別** | **職稱** | **分機** | **email** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**報 名 資 訊**

* 時　間：2015年12月17日(星期四) 上午9:00~12:00
* 地　點：台北台大醫院國際會議中心402AB會議室(台北市中正區徐州路2號)
* 報名表填妥完畢請傳真至(07)353-3978，請於12/11(五)前完成報名
* 填寫單位名稱、學員姓名、電話、email等。傳真至(07)353-3978，始完成報名手續。
* 洽詢電話：(07)351-3121分機2337何小姐或分機2386劉小姐

**財團法人金屬工業研究發展中心**

**個人資料蒐集、處理、利用告知暨同意書**

本中心因受經濟部技術處委託執行/辦理智慧鍍膜之發展趨勢及應用展望研討會之事由，蒐集、處理及利用您所提供，或未來將提供的個人資料，茲依據個人資料保護法（以下稱個資法）第8條規定告知下列事項：

(一)蒐集目的：辦理本次活動及相關行政管理。

(二)個資類別：辨識個人者如姓名、職稱、聯絡方式、地址等。

現行之受僱情形如公司名稱、部門、職稱等。

(三)利用期間：至蒐集目的消失為止。

(四)利用地區：除蒐集之目的涉及國際業務或活動外，本中心僅於中華民國領域內利用您的個人資料。

(五)利用對象及方式：於蒐集目的之必要範圍內，利用您的個人資料。

(六)當事人權利：您可向本中心「個資當事人權利行使窗口」行使查詢或請求閱覽、製給複製本、補充或更正、停止蒐集處理利用或刪除您的個人資料之權利，電話：07-3513121轉2360。

(七)不同意之權益影響：若您不同意提供個人資料，本中心將無法為您提供特定目的之相關服務。

**辦理本次活動外其他蒐集目的告知：**

蒐集目的：寄送本中心舉辦之活動或產業相關之訊息。

本人已閱讀並了解上述之告知事項，並同意 貴中心在符合上述告知事項範圍內蒐集、處理及利用本人個人資料。

立書人簽名：

日 期： 年 月 日